

**快克智能装备股份有限公司**  
**关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署**  
**《进区协议》的公告**

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。**

**重要提示：**

- 计划总投入约 10 亿元建设半导体封装设备研发及制造项目。
- 本次投资是以竞买目标土地为前提，项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。
- 本次项目存在备案（或核准）和前期环保评估、安全评估、能源评估时，部分或全部不能通过有关部门批准导致本协议终止的风险。
- 公司本次项目投资是基于当前市场环境、公司战略规划而做出的决策。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的投资开发实施可能存在延期、变更或终止的风险。项目投资金额为计划数或预期数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺；后续公司将根据情况决定是否增加或减少投资。
- 本项目投资规模、建设周期、实施进度及执行情况等存在不确定性，尚需合作双方进一步沟通和落实。公司将按照有关法律法规，及时履行相应的决策程序及信息披露义务。
- 本次项目投资资金来源为公司自有资金、直接或间接融资，本次投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷

政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金风险。

● 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。尚需提交公司股东大会审议。

## 一、对外投资概述

快克智能装备股份有限公司（以下简称“快克智能”或“公司”）致力于为精密电子组装&半导体封装领域提供智能装备解决方案，聚焦半导体封装、新能源、智电汽车、智能终端智能穿戴、精密电子（医疗电子、数据通信）等多个行业应用领域。公司将精密焊接技术及装备自动化能力拓展至功率半导体封装领域，自主研发的纳米银烧结设备，突破第三代半导体功率芯片封装“卡脖子”技术，该项目已被江苏省工信厅认定为关键核心技术(装备)攻关产业化项目，随着IGBT多功能固晶机、甲酸焊接炉及固晶键合AOI的开发成功，已形成功率半导体封装成套解决方案的能力。公司将持续研发高速高精控制系统等技术，积极布局先进封装高端设备领域。

为推动公司整体战略布局，积极发展公司半导体装备业务，着力打造半导体封装成套解决方案，快克智能拟与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署《进区协议》，投资建设“半导体封装设备研发及制造项目”（以下简称“项目”），项目计划总投资约10亿元；同时，由董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署协议书。上述事项已经公司于2023年5月8日召开的第四届董事会第七次会议审议通过。

本次对外投资事项不属于关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议。

## 二、协议对方的基本情况

- 1、名称：武进国家高新技术产业开发区管理委员会
- 2、性质：地方政府
- 3、与公司关系：与公司、控股股东及实际控制人均不存在关联关系

### 三、项目基本情况

#### （一）实施主体

公司名称：江苏快克芯装备科技有限公司

公司类型：有限责任公司

成立日期：2023年4月14日

注册资本：叁仟万圆整

法定代表人：戚国强

公司住所：武进国家高新技术开发区凤翔路11号

统一社会信用代码：91320412MACFATYC05

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；集成电路芯片及产品制造；工业自动控制系统装置制造；电子测量仪器制造；工业自动控制系统装置销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；工程和技术研究和试验发展；标准化服务；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；工业机器人销售；智能机器人的研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；人工智能硬件销售；软件开发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：公司直接持有100.00%的股权。

#### （二）项目标的基本情况

项目名称：半导体封装设备研发及制造项目

建设地点：武进国家高新技术产业开发区

投资规模：预计约10亿元，最终以实际投资为准

计划用地：约68亩，以公开出让方式依法取得国有建设用地使用权

资金来源：拟通过自有资金、直接或间接融资等方式

#### 四、对外投资合同的主要内容

##### （一）协议主体

甲方：武进国家高新技术产业开发区管理委员会

乙方：快克智能装备股份有限公司

##### （二）项目概况

乙方将在武进国家高新区注册成立新公司，投资建设半导体封装设备研发及制造项目；项目总投资10亿元。

##### （三）项目用地

甲方向乙方新公司出让国有工业用地约68亩，地块位置位于凤翔路与阳湖西路西北角（具体面积以规划部门宗地图为准）。

##### （四）双方责任

甲方积极协助乙方新公司享受政府出台的产业、科技等方面的扶持政策，以促进公司快速发展。

甲方积极做好乙方新公司经营过程涉及的相关服务工作（如立项、环评等手续办理），协调设立过程中出现的矛盾和问题，使公司在武进国家高新区得到健康、快速地发展。

乙方或乙方新公司应在竞得土地后尽快启动建设。

##### （五）合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，未尽事宜，经甲乙双方协商后重签补充协议。

#### 五、本次交易的目的和对公司的影响

公司投资建设半导体封装设备研发及制造项目，是响应国家政策指引、顺应产业发展趋势、落实公司战略规划的重要举措，拟进一步加强公司半导体装备业务的研发创新能力及制造产能建设，着力打造半导体封装成套解决方案，积极布局先进封装高端设备领域，提升公司品牌知名度和市场影响力，实现半导体业务板块做大做强；同时，从公司整体层面保持创新活力，促进产品结构升级优化，持续增强核心竞争力，为公司长期稳健发展奠定坚实基础。

本次项目投资建设将增加公司资本开支和现金支出，但从长远来看符合公司

战略发展规划，对公司业务布局和经营业绩具有积极影响，符合公司及全体股东的利益。

## 六、风险提示

（一）本次投资是以竞买目标土地为前提，项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性。

（二）本次项目存在备案（或核准）和前期环保评估、安全评估、能源评估时，部分或全部不能通过有关部门批准导致本协议终止的风险。

（三）公司本次项目投资是基于当前市场环境、公司战略规划而做出的决策。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的投资开发实施可能存在延期、变更或终止的风险。项目投资金额为计划数或预期数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺；后续公司将根据情况决定是否增加或减少投资。

（四）本项目投资规模、建设周期、实施进度及执行情况等存在不确定性，尚需合作双方进一步沟通和落实。公司将按照有关法律法规，及时履行相应的决策程序及信息披露义务。

（五）本次项目投资资金来源为公司自有资金、直接或间接融资，本次投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金风险。

公司将根据本次投资事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、快克智能装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、《进区协议》

特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会

2023年5月9日